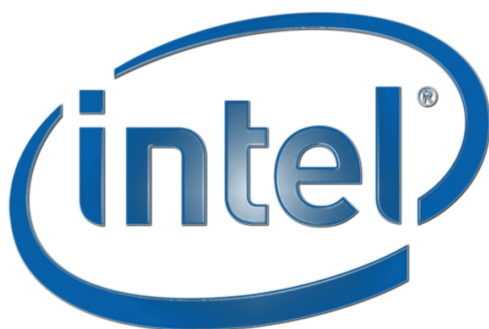


Nuove indiscrezioni su Broadwell-E & Kaby Lake



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/processor-chipset/7207/nuove-indiscrezioni-su-broadwell-e-kaby-lake.htm>)

Ecco cosa ci sta preparando Intel per il 2016 ...



In questi giorni sono cominciate ad arrivare le prime conferme sulle specifiche ed i modelli delle CPU HEDT di Intel a 14nm attese per il primo semestre del 2016 e, a seguire, sono emersi importanti dettagli anche sulla nuova piattaforma mainstream, nome in codice Kaby Lake, che dovrebbe essere introdotta entro la

fine dello stesso anno.

Ma andiamo per ordine ...

Con Broadwell-E sarà introdotto il primo processore consumer dotato di ben 10 core, affiancato da una cache L3 di ben 25MB (2,5MB per ogni core).

Il modello di punta sarà il Core i7 6950X che oltre ad avere le specifiche appena menzionate, avrà una frequenza di base di 3,0GHz che salirà a 3,5GHz in modalità Turbo Boost con moltiplicatore rigorosamente sbloccato.

Confermata la compatibilità per le attuali schede madri equipaggiate con chipset X99 e socket LGA 2011-v3, sarà aggiunto il supporto ufficiale alle DDR4 con frequenza di 2400MHz in luogo dei canonici 2133MHz (aspetto piuttosto marginale dato le capacità in overlock dell'attuale IMC integrato sui processori Haswell-E).

Al top di gamma, che sarà proposto come al solito a 999\$, si aggiungeranno nell'ordine il Core i7-6900K (8 core e 20MB di Cache L3) ed i Core i7-6850K e 6800K (entrambi con 6 core e 15MB di cache L3) che arriveranno in un secondo momento, probabilmente in estate.

Passiamo ora alla 7^a generazione dei processori Intel Core comprendente i chip serie H, S, U e Y, che saranno invece lanciati nel secondo semestre 2016 affiancati dai nuovi chipset serie 200 "Union Point".

Kaby Lake, che offrirà prestazioni migliori tra il 5 ed 10% rispetto alla precedente generazione, sarà sempre realizzato con un processo produttivo a 14nm e risulterà compatibile con il socket LGA 1151 e chipset della serie 100, un po' come successo nel passaggio da Z87 a Z97.

Il vantaggio nell'abbinamento dei nuovi processori ai chipset serie 200 consisterà essenzialmente nell'aumento delle prestazioni di I/O che saranno quindi in grado di supportare con Kaby Lake-S la velocità offerta dalle periferiche di storage Intel Optane, SSD e DIMM, grazie alla avanzata architettura 3D XPoint.

Le caratteristiche di base di Union Point includono il supporto sino a 24 linee PCI-E (contro le 20 offerte dai chipset 100 Sunrise Point), sei porte SATA 3.0 e 10 USB 3.0.

Più o meno invariati i consumi di Kaby Lake con modelli dual e quad core da 35, 65 e 95W di TDP, questi ultimi (in versione K) con moltiplicatore sbloccato.

A tale proposito segnaliamo che, al contrario degli altri modelli (2+2 e 4+2), i quad core 4+4 di Kaby Lake-S saranno compatibili solo ed esclusivamente con i nuovi chipset serie 200.